

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年10月6日(06.10.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/210241 A1

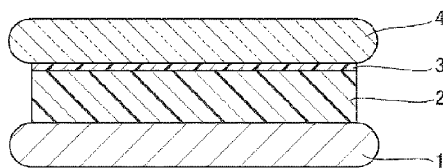
- (51) 国際特許分類:
C09K 3/00 (2006.01) C09J 7/35 (2018.01)
H01L 21/02 (2006.01) B32B 7/06 (2019.01)
H01L 21/304 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/013867
- (22) 国際出願日: 2022年3月24日(24.03.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-061649 2021年3月31日(31.03.2021) JP
- (71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 森谷 俊介 (MORIYA Shunsuke); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 奥野 貴久 (OKUNO Takahisa); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).
- (74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階 高岡 I P特許事務所 Tokyo (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: LAMINATE, RELEASE AGENT COMPOSITION, AND METHOD FOR MANUFACTURING MACHINED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 積層体、剥離剤組成物及び加工された半導体基板の製造方法



(57) Abstract: This laminate includes a semiconductor substrate, a light-transmissive support substrate, and an adhesive layer and a release layer provided between the semiconductor substrate and the support substrate, wherein: light emitted from the support substrate side is absorbed by the release layer and then used to cause the semiconductor substrate and the support substrate to be peeled off; the release layer is a layer formed from a release agent composition; and the release agent component has a structure that absorbs the light and contains a compound having a first structure which contributes to the semiconductor substrate and the support substrate being easier to peel off by absorbing the light, and which has two or more aromatic rings constituting a π electron conjugated system, and having a siloxane structure serving as a second structure.

[続葉有]

WO 2022/210241 A1

(57) 要約：半導体基板と、光透過性の支持基板と、前記半導体基板と前記支持基板との間に設けられた、接着層と剥離層とを有し、前記支持基板側から照射された光を前記剥離層が吸収した後に前記半導体基板と前記支持基板とが剥がされることに用いられる積層体であって、前記剥離層が、剥離剤組成物から形成される層であり、前記剥離剤組成物が、前記光を吸収する構造であり、前記光を吸収することによって前記半導体基板と前記支持基板とが剥がされやすくなることに寄与し、かつ π 電子共役系を構成する2つ以上の芳香族環を有する第1構造、及び第2構造としてのシロキサン構造を有する化合物を含有する、積層体。